（上接B085版）

入规模有所增加；同时，考虑到受新冠疫情影响经济发展有所变缓，产业链下游企业资金较为紧张，公司采取了较为灵活的货款回收制度，在保障货款收回的前提下，银行承兑汇票回款有所增加，相应的应收账款金额及占营业收入比重有所下降。2021年，半导体国产化趋势明显，行业景气度提升，公司抓住市场机遇，及时实现进口替代，不断优化客户结构，营业收入规模大幅增长。此外，公司基于市场供需关系，适时加强货款清收力度，引致2021年末应收账款占营业收入比重下降。

综上，报告期各期末，公司应收账款金额占收入的比重与公司业务发展情况相匹配，应收账款金额具有合理性。

2、周转率及同行业可比上市公司情况

报告期各期，公司应收账款周转率、周转天数情况如下：

项 目	2021年末/2021年度	2020年末/2020年度	2019年末/2019年度
应收账款周转率	13.12	9.92	10.04
应收账款周转天数	27.82	36.79	36.35

注：上表中应收账款周转率均以账面价值为计算依据；应收账款周转天数=365/应收账款周转率。

报告期内，公司应收账款周转率分别为10.04、9.92和13.12，保持在较高水平，应收账款金额与收入规模相匹配；从应收账款周转天数来看，报告期内公司应收账款周转天数分别为36.35天、36.79天和27.82天，总体与公司给予客户的信用期接近，应收账款金额合理。

报告期内，公司与同行业公司应收账款周转率情况如下：

同行业公司	2021年1-9月	2020年度	2019年度
富满微	3.98	2.21	2.23
华微电子	5.38	4.07	3.73
韦尔股份	9.32	7.83	7.97
扬杰科技	4.72	3.68	3.35
台基股份	4.05	5.87	2.88
斯达半导	5.27	4.12	4.46
平均值	5.45	4.63	4.10
新洁能	13.54	9.92	10.04

注：上表中数据根据各公司定期报告计算，上述应收账款周转率均以账面价值为计算依据；截至本反馈回复之日，同行业可比上市公司尚未公布2021年报，以2021年1-9月数据年化后进行比较。

报告期内，公司应收账款周转率高于同行业上市公司平均水平，应收账款管理效率较高，金额较为合理。

综上，报告期各期末，公司应收账款金额与营业收入较为匹配，金额波动情况与公司业务模式、经营状况等密切相关，应收账款周转率较高，高于同行业上市公司平均水平，应收账款存在合理性。

（二）坏账准备计提情况，结合期后回款情况、账龄分布占比情况及可比公司情况说明应收账款坏账准备计提的充分性

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2021年末		2020年末		2019年末	
	余额	比例	余额	比例	余额	比例
应收账款余额	14,426.56	100.00%	9,727.97	100.00%	10,588.73	100.00%
坏账准备	795.21	5.51%	519.07	5.34%	536.50	5.07%
应收账款账面价值	13,631.35	94.49%	9,208.90	94.66%	10,052.23	94.93%

报告期各期末，公司应收账款坏账准备的计提比例分别为5.07%、5.34%和5.51%。

1、期后回款情况

报告期各期，公司应收账款期后回款情况如下：

单位：万元

日期	应收账款余额	截至下一年期末回款金额	回款比例
2021年12月31日	14,426.56	11,393.46	78.98%
2020年12月31日	9,727.97	9,540.24	98.07%
2019年12月31日	10,588.73	10,440.76	98.60%

注：2021年12月31日的“截至下一年期末回款金额”为截至2022年2月28日的回款情况。

如上表所示，报告期各期末公司的应收账款在下一期末前回款比例较高，应收账款期后回款情况良好，2019年、2020年年末应收账款的期后未回款比例均小于坏账准备计提比例，应收账款坏账准备计提充分。

2、账龄分布占比情况

报告期各期，公司应收账款账龄分布情况如下：

单位：万元

项目	2021年末		2020年末		2019年末	
	余额	比例	余额	比例	余额	比例
1年内	14,238.83	98.70%	9,580.00	98.48%	10,526.57	99.41%
1-2年	58.31	0.40%	90.81	0.93%	42.38	0.40%
2-3年	74.25	0.51%	37.38	0.38%	19.78	0.19%
3年以上	55.16	0.38%	19.78	0.20%	-	-
合计	14,426.56	100.00%	9,727.97	100.00%	10,588.73	100.00%
减：坏账准备	795.21	5.51%	519.07	5.34%	536.50	5.07%
账面价值	13,631.35	94.49%	9,208.90	94.66%	10,052.23	94.93%

报告期各期末，公司账龄1年以内应收账款余额占比均超过98%，公司应收账款账龄整体较短，应收账款质量良好。报告期各期末公司计提的坏账准备余额分别为536.50万元、519.07万元和795.21万元，各期末坏账准备余额均能覆盖账龄一年以上的应收账款金额。报告期内，公司未发生应收账款坏账准备核销的情形。

3、与同行业可比公司坏账计提政策比较分析

报告期内，公司的应收账款坏账准备计提政策为：对于划分为组合的应收账款-应收客户货款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。实际计算时，按照预期信用损失率计算的坏账准备计提比例与同行业可比公司对比如下：

项 目	应收账款坏账准备计提比例						
	富满微	华微电子	韦尔股份	扬杰科技	台基股份	斯达半导	新洁能
1年以内	5.00%	2019年1.29% 2020年1.23%	5.00%	5.00%	未披露	5.00%	5.00%
1-2年	10.00%	2019年29.71% 2020年36.62%	20.00%	10.00%		10.00%	10.00%
2-3年	30.00%	2019年37.12% 2020年51.00%	50.00%	50.00%		20.00%	30.00%
3-4年	100.00%	2019年75.69% 2020年74.44%	100.00%	100.00%		50.00%	100.00%
4-5年		2019年75.69% 2020年74.44%				80.00%	
5年以上		100.00%				100.00%	

注：上表中数据根据各公司定期报告计算；截至本反馈回复之日，同行业可比上市公司尚未公布2021年报。

如上表所示，报告期内，对于划分为组合的应收账款-应收客户货款，公司坏账计提政策与同行业可比公司相比处于中间水平。

综上，报告期内，公司应收账款的期后回款情况良好，账龄一年以内的应收账款余额超过98%，坏账准备计提政策与同行业公司可比，应收账款坏账准备计提充分、合理。

二、应收票据中商业承兑汇票、银行承兑汇票的金额、占比情况，结合应收票据逾期情况补充说明是否计提坏账准备及合理性

（一）应收票据中商业承兑汇票、银行承兑汇票的金额、占比情况

报告期各期末，公司应收票据中商业承兑汇票、银行承兑汇票的金额及占比情况如下：

单位：万元

项目	2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
银行承兑汇票	16,262.13	99.94%	28,782.45	100.00%	14,938.24	100.00%
商业承兑汇票	9.83	0.06%	-	0.00%	-	0.00%
合计	16,271.96	100.00%	28,782.45	100.00%	14,938.24	100.00%

报告期各期末，公司应收票据金额分别为14,938.24万元、28,782.45万元和16,271.96万元，公司应收票据主要为银行承兑汇票。

（二）结合应收票据逾期情况补充说明是否计提坏账准备及合理性

1、应收票据坏账准备计提情况及应收票据逾期情况

报告期内，公司应收票据坏账准备计提情况如下：

单位：万元

年度	类型	余额	坏账准备	计提比例	账面价值
2021年	银行承兑汇票	16,262.13	-	-	16,262.13
	商业承兑汇票	10.34	0.52	5.00%	9.83
2020年	银行承兑汇票	28,782.45	-	-	28,782.45
	商业承兑汇票	-	-	-	-
2019年	银行承兑汇票	14,938.24	-	-	14,938.24
	商业承兑汇票	-	-	-	-

报告期内，公司已到期应收票据均实现兑付，不存在逾期情况，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据，公司应收票据相关的信用风险极小。报告期各期末，公司账面应收票据主要为银行承兑汇票，且承兑人为国有六大银行及全国股份制商业银行的银行承兑汇票占比较高。报告期内，未发生银行承兑汇票无法兑付的情形，公司的银行承兑汇票相关信用风险极小，报告期各期末无需计提坏账准备；2021年末，公司账面有少量商业承兑汇票，公司已按照预期信用损失模型，基于风险特征将其划分为账龄组合的应收款项，并计提相应的坏账准备。

2、同行业应收票据坏账准备计提情况

根据同行业上市公司年报披露内容，报告期内，同行业上市公司对应收票据项目中的银行承兑汇票和应收款项融资项目均未计提坏账准备，与公司银行承兑汇票坏账准备计提政策一致，公司银行承兑汇票未计提坏账准备具有合理性。

根据同行业上市公司年报披露内容，报告期各期末，账面存在商业承兑汇票的同行业上市公司的商业承兑汇票坏账准备计提比例如下：

同行业公司	2021年度	2020年度	2019年度
韦尔股份	未公告年报	5.00%	5.00%
扬杰科技	未公告年报	0.00%	0.00%
台基股份	未公告年报	0.00%	当期未无商业承兑汇票
新洁能	5.00%	当期未无商业承兑汇票	当期未无商业承兑汇票

根据上表，报告期各期末，韦尔股份、扬杰科技、台基股份账面曾存在商业承兑汇票，其中除韦尔股份对商业承兑汇票的坏账准备计提比例为5.00%外，扬杰科技、台基股份均未对商业承兑汇票计提坏账准备。报告期内，公司仅2021年末存在商业承兑汇票，当期末已按照预期信用损失模型计提坏账准备，计提比例为5.00%，公司商业承兑汇票坏账准备计提充分。

综上，报告期内公司应收票据不存在逾期情况，坏账准备计提政策与同行业上市公司可比，应收票据坏账准备计提具有合理性。

三、存货余额较高的原因，报告期内存货跌价准备计提政策，结合存货周转率、库龄分布及占比、期后价格变动、同行业上市公司等情况，说明存货跌价准备计提的充分性。

（一）存货余额较高的原因

报告期内，公司业务模式以Fabless为主，即主要从事半导体的设计和销售，而将芯片制造、封装测试等环节主要委托给芯片代工企业、封装测试企业代工完成。公司提供GDS版图文件、材料规格文件、工艺流程文件等至芯片代工企业进行芯片生产，在收到芯片后由公司提供芯片及封装规格书至封测供应商或由子公司电基集成自主封测形成功率器件产品。

因此，公司存货依据性质划分为原材料、半成品、委托加工物资、在制品、产成品。其中，①原材料主要系公司子公司电基集成采购的封装测试所需的原材料；②半成品为芯片，由芯片代工企业完成代工生产，将芯片交付公司后公司将其作为半成品入库。芯片可以直接对外出售，亦可以进一步封装成成品再对外出售；③委托加工物资为委托封装代工企业进行封测尚未回货的芯片；④在制品为投入自有封装生产线进行封装测试尚未最终完工的产品；⑤产成品为完成封测并交付公司后的功率器件产品。

报告期各期末，公司存货余额如下：

单位：万元

项目	2021年末	2020年末	2019年末
原材料	690.71	262.46	175.07
半成品	6,495.52	1,565.70	4,096.26
委托加工物资	6,187.15	4,703.89	2,804.53
产成品	9,384.49	3,871.12	6,612.76
在制品	1,452.76	788.96	227.71
余额合计	24,210.62	11,192.13	13,916.32
跌价准备	173.95	280.85	213.32
账面价值	24,036.67	10,911.28	13,703.00
存货占流动资产比例	15.94%	8.78%	19.76%

报告期各期末，公司存货余额分别为13,916.32万元、11,192.13万元、24,210.62万元。公司的业务模式决定公司存货中原材料极少，存货主要由为半成品、委托加工物资、产成品构成，合计占比90%以上。

从存货金额来看，报告期各期末，公司存货账面余额总体呈上升趋势，主要系：报告期内，公司主要结合市场需求情况、在手订单金额确定生产运营计划，进行存货采购备货。由于下游市场需求总体持续向好，行业景气度较高，国产趋势逐步显现，公司年销售收入持续提升。公司生产运营计划采用订单和备货相结合的模式，为快速响应客户需求，公司各期末存货备货金额整体较大。

2020年末，存货账面价值较2019年有所下降，主要系：2020年下半年以来，受益于消费电子、汽车电子等需求回升以及新冠疫情催生的新市场需求，功率器件国产替代效益逐步显现，加之上游芯片代工产能相对紧张，公司产品整体呈现供不应求的情形，期末结余库存金额有所下降。2021年以来，公司与华虹宏力、华润上华等本土主要的芯片代工企业进一步加强紧密合作，加大在12英寸芯片代工平台上的技术开发力度，实现了12英寸芯片及功率器件的量产开发和稳定供货，公司上游芯片代工产能有所提升，加之为应对市场需求的持续旺盛，主动加大了库存备货，相应的期末结余存货金额增长明显。

报告期各期末，公司存货账面价值占流动资产比例与同行业可比上市公司对比情况如下：

公司名称	2021年9月末	2020年末	2019年末
富满微	19.48%	20.13%	31.19%
华微电子	7.52%	7.86%	5.93%
韦尔股份	37.64%	37.90%	40.13%
扬杰科技	21.15%	21.34%	18.90%
台基股份	10.58%	21.10%	26.94%
斯达半导	27.89%	24.05%	35.21%
平均值	20.71%	22.07%	26.38%
新洁能	10.31%	8.78%	19.76%

注：上表中数据根据各公司定期报告计算；截至本反馈回复之日，同行业可比上市公司尚未公布2021年报，以2021年9月末数据进行比较。

2019年末、2020年末、2021年9月末，公司存货占流动资产比例分别为19.76%、8.78%和10.31%，低于行业平均值。2020年占比相对较低的主要系公司于2020年9月IPO上市成功，募集资金增加流动资产所致；2021年，公司生产经营及货款回收情况良好，经营活动产生的现金流量净额较高，期末银行存款、交易性金融资产等金额进一步上升推动流动资产明显增加，相应的存货账面价值占流动资产的比例仍较低。

综上，公司存货金额较高符合公司业务发展实际和行业特点，且存货占流动资产比例低于同行业可比上市公司平均值，存货规模具备合理性。

（二）报告期内存货跌价准备计提政策，结合存货周转率、库龄分布及占比、期后价格变动、同行业上市公司等情况，说明存货跌价准备计提的充分性。

报告期内，存货跌价准备计提政策为：公司按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。具体方式为：各期期末，公司排查是否存在由于产品市场竞争状况导致销售价格下跌、产品质量问题降级销售等原因导致的产品售价低于结存成本的情况，对于产品售价低于结存成本的存货计提存货跌价准备，可变现净值根据已签合同价格并结合市场行情的变化确定，财务部对可变现净值低于结存单位成本之差额计提存货跌价准备；此外，对结存时间1年以上之存货作为呆滞品计提减值，其中，批量结存的根据历史经验按一定的折扣率作为可变现净值，零散料按照结存金额全额计提存货跌价准备。

1、存货周转率

公司名称	2021年1-9月	2020年度	2019年度
富满微	2.38	2.60	2.07
华微电子	8.15	6.13	6.71
韦尔股份	2.59	2.88	3.75
扬杰科技	4.52	4.53	4.38
台基股份	1.97	1.81	1.30
斯达半导	3.59	2.91	3.16
平均值	3.87	3.48	3.56
新洁能	6.97	5.79	4.93

注：上述存货周转率以存货账面价值计算；同行业可比公司暂未披露2021年报，上表中以2021年1-9月年化后进行比较。

根据上表，公司存货周转率与扬杰科技较为接近，整体高于行业平均水平，主要原因为公司与上述可比上市公司生产经营模式及产品类型存在差异，公司主要为Fabless模式并向封装测试环节延伸产业链，相应的原材料等备货金额较低。此外，公司重视库存管理，依据订单及市场预期合理备货，库存周转效率较高。

2、库龄分布及占比

报告期各期末，公司存货库龄分布及占比如下：

单位：万元

报表截止日	账面余额	库龄分布			
		1年以内金额	占比	1年以上金额	占比
2021年12月31日	24,210.62	23,854.28	98.53%	356.34	1.47%
2020年12月31日	11,192.13	10,580.62	94.54%	611.51	5.46%
2019年12月31日	13,916.32	13,452.73	96.67%	463.59	3.33%

截至各报告期末，公司存货库龄主要为一年以内，一年以内库龄占比94%以上，期末存货库龄分布情况较为合理，符合企业实际生产经营特点，不存在大量积压存货的情况。

3、期后价格变动

报告期各期末，公司库存商品的期后销售情况如下：

单位：元/千只

主要存货类别	2021年度		2020年度		2019年度	
	库存商品期末结存均价	期后销售均价	库存商品期末结存均价	期后销售均价	库存商品期末结存均价	期后销售均价
沟槽型功率MOSFET	270.69	360.75	269.40	285.20	192.25	249.10
屏蔽栅沟槽型功率MOSFET	1,225.69	1,695.88	1,000.81	1,509.64	1,162.30	1,291.08
超结功率MOSFET	1,275.08	1,879.39	1,163.38	1,568.74	1,530.66	1,553.58
绝缘栅双极型晶体管(IGBT)	2,731.99	4,256.93	1,570.66	1,645.81	1,747.00	2,557.93

注：期后销售价格为期后1-3月份销售均价，2021年期后销售均价为2022年1-2月份销售均价。

报告期期后销售情况总体较好，价格未出现重大不利变化情况，整体不存在明显积压或滞销的情形。4、同行业上市公司情况

报告期内，公司与同行业上市公司存货跌价准备占存货账面余额的计提比例如下：

公司名称	2021年6月末	2020年末	2019年末
富满微	4.34%	4.34%	6.54%
华微电子	6.32%	5.24%	4.45%
韦尔股份	12.12%	12.72%	12.02%
扬杰科技	3.40%	3.97%	5.11%
台基股份	0.89%	15.58%	0.72%
斯达半导	0.86%	0.77%	1.00%
平均值	4.65%	7.10%	4.97%
新洁能	1.08%	2.51%	1.53%

注：上表中数据根据各公司定期报告计算；截至本反馈回复之日，同行业可比上市公司尚未公布2021年报，以2021年6月末数据进行比较。

2019年末、2020年末、2021年6月末，公司的存货跌价准备计提比例分别为1.53%、2.51%和1.08%，低于同行业可比上市公司平均值。其中韦尔股份由于其部分为代理销售业务，其存货周转效率较低，期末存货余额较大，因此计提存货跌价准备金额较高。华微电子、扬杰科技为IDM模式企业，存货中还包括晶圆制造原材料等，其存货跌价计提比例亦较高。公司存货跌价准备计提比例相对较低主要系：公司主要为Fabless模式，专注于芯片设计和销售，芯片代工和封测供应主要为华虹宏力、华润上华、长电科技等专业的行业龙头企业，采购芯片质量突出、稳定，封装良率较高，与IDM企业相比具有分工带来的效率、良率优势；另一方面，报告期内公司销售收入稳定增长，存货流转速度较快，存货账龄基本在1年以内，存货周转效率较高，故公司存货跌价准备计提比例低且相对稳定。

综上，公司已根据存货跌价准备计提政策计提相应的存货跌价准备，计提比例符合公司业务实际情况且相对稳定，因此公司存货跌价准备计提充分。

【中介机构核查意见】

（一）核查程序

1、保荐机构和申请人会计师了解了发行人的客户信用管理制度，获取了报告期各期末发行人应收账款、应收票据的明细账，了解了应收账款和应收票据的构成情况；

2、保荐机构和申请人会计师访谈了发行人财务部门负责人，对发行人主要客户进行了访谈，了解了报告期内行业发展状况、下游供需关系变化情况，了解了报告期内发行人给予客户的信用政策以及应收款项管理情况，对应收款项金额及波动的合理性进行分析；

3、保荐机构和申请人会计师获取了发行人报告期内主要客户的销售订单，对主要客户销售情况执行了抽凭；

4、保荐机构和申请人会计师访谈了发行人财务部门负责人，了解可发行人应收账款、应收票据的坏账准备计提政策；

5、保荐机构和申请人会计师查阅了发行人的存货明细表、销售明细表，并对2021年末存货进行监盘，了解存货结构、期后销售、库龄情况及余额较高的原因；

6、保荐机构和申请人会计师查阅了同行业上市公司的公开资料，比较了同行业上市公司与发行人的坏账准备、存货跌价准备等。

（二）核查意见

经核查，保荐机构和申请人会计师认为：

1、报告期各期末，公司应收账款金额与营业收入较为匹配，金额波动情况与公司业务模式、经营状况等密切相关，应收账款周转率较高，高于同行业上市公司平均水平，应收账款存在合理性。

2、报告期内，公司应收账款的期后回款情况良好，账龄一年以内的应收账款余额超过98%，坏账准备计提政策与同行业公司可比，应收账款坏账准备计提充分、合理。

3、报告期内公司应收票据不存在逾期情况，坏账准备计提政策与同行业上市公司可比，应收票据坏账准备计提具有合理性。

4、公司存货余额较高与生产经营相关，具有合理性。公司存货计提跌价准备计提充分。

7.报告期内申请人应付账款、应付票据余额较高。请申请人：（1）结合报告期内采购政策、业务规模等情况，说明应付账款余额较大的原因及合理性。（2）说明报告期内前五大应付账款方基本情况、采购内容、金额及占比，是否存在关联关系等。（3）应付票据余额较大的原因及合理性，结合应付票据对手方性质、交易金额等具体情况说明是否存在开具无真实交易背景票据的情形。请保荐机构和会计师发表核查意见。

回复：

一、结合报告期内采购政策、业务规模等情况，说明应付账款余额较大的原因及合理性。

1、采购政策

公司是半导体行业专业化垂直分工企业，主要负责半导体功率器件的研发设计及销售，并向封测环节延伸。公司芯片代工主要通过芯片代工厂制造而成，封装测试部分委托封测代工厂加工完成。

对于芯片代工，销售处根据历史订单、市场需求状况以及产品的库存情况制定销售和采购预测，运营处据此制定采购和生产计划，研发处负责提供技术支持以及质量控制。公司与主要芯片代工企业签订框架合作协议，运营处将订单和产品规格书（包括外延片规格、关键部位工艺参数、测试规范等）发给芯片代工企业进行制造。芯片代工完成后，公司研发处对代工芯片确认合格后，由公司运营处安排回货。回货后公司仓管部对其外观、数量、规格等进行点检验收并入库。

对于委外封装测试，公司与主要封装测试供应商签订合作协议，运营处将封装订单、封装规格书（包括工艺参数、测试规范等）以及芯片提供给封装测试供应商进行封装测试后发回公司，公司研发处进行产品抽测检验，在检验合格后由仓管部安排产品入库。

对于自主封装测试，公司建成封装测试产线，并对部分功率器件实现自主封装测试。公司全资子公司电基集成对生产过程进行总体控制和管理，保证生产计划的顺利完成。

公司制定了《采购付款管理制度》《晶圆采购流程》《封装服务采购流程》《采购合同管理制度》《设备采购管理制度》等内部控制文件。采购业务由运营处下属采购部门协调财务及使用部门共同完成，报总经理审批。使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，合同风险条款的审查。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集；同时，负责与供方联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。采购部根据合同约定的付款方式及付款时间向上级主管部门提出申请，各主管签字，后附入库单（验收合格），交给财务部办理付款手续。

公司与主要供应商已形成稳固的合作关系，主要供应商通常会给公司一定的信用期，公司在货物验收入库并取得供应商发票后，通常30-90日内向供应商付款。公司通常以现款+承兑的方式与客户结算，相应的形成一定的应付账款及应付票据。

2、业务规模

报告期各期末，公司应付账款余额占当期采购总额的比例情况如下：

单位：万元

项目	2021年末/2021年度	2020年末/2020年度	2019年末/2019年度
应付账款	18,507.03	12,429.42	12,935.99
采购总额	106,018.96	71,015.89	65,511.31
应付账款占采购总额比例	17.46%	17.50%	19.75%

报告期内，公司应付账款余额随着自身业务发展和生产经营的实际情况而波动，2019年和2020年，公司应付账款余额整体稳定；2021年，公司业务规模增长明显，当期采购金额上升引致期末应付账款增长明显。

报告期各期，公司应付账款余额占当期采购总额的比例分别为19.75%、17.50%和17.46%，应付账款余额占采购总额的比例总体相对稳定。2020年和2021年，公司应付账款占采购总额的比例略低的原因为：受市场供需关系变化影响，2020年下半年以来，半导体行业景气度提升，公司为保障产能供应，积极向供应商支付款项所致。

综上，报告期内，公司应付账款余额随自身业务发展和生产经营的实际情况而波动，应付账款规模与公司采购政策和业务规模相匹配，具有合理性。

二、说明报告期内前五大应付账款方基本情况、采购内容、金额及占比，是否存在关联关系等。

报告期内，公司前五大应付账款方基本情况、采购内容、金额及占比情况具体如下：

1、前五大应付账款方采购内容、金额及占比

单位：万元

期间	名称	应付账款金额	采购金额（不含税）	采购占比	采购内容
2021年度	华虹半导体（无锡）有限公司	7,235.86	31,979.29	30.16%	芯片代工
	上海华虹宏力半导体制造有限公司	6,265.22	40,534.58	38.23%	芯片代工
	扬州国宇电子有限公司	583.93	1,669.44	1.57%	芯片采购
	上海芯哲微电子科技股份有限公司	489.40	2,906.55	2.74%	封测服务
	成都集佳科技有限公司	371.29	4,449.80	4.20%	封测服务
	合计	14,945.70	81,539.66	76.91%	-
2020年度	上海华虹宏力半导体制造有限公司	6,621.13	40,258.50	56.69%	芯片代工
	华虹半导体（无锡）有限公司	2,150.43	3,975.45	5.60%	芯片代工
	江苏长电科技股份有限公司	790.03	3,293.80	4.64%	封测服务
	上海芯哲微电子科技股份有限公司	465.03	2,113.18	2.98%	封测服务
	江苏友润微电子有限公司	319.16	992.97	1.40%	封测服务
	合计	10,345.78	50,633.89	71.30%	-
2019年度	上海华虹宏力半导体制造有限公司	8,827.50	38,743.81	59.14%	芯片代工
	江苏长电科技股份有限公司	1,120.21	3,936.98	6.01%	封测服务
	上海芯哲微电子科技股份有限公司	387.68	1,548.75	2.36%	封测服务
	无锡华润上华科技有限公司	380.39	8,789.16	13.42%	芯片代工
	成都集佳科技有限公司	258.70	2,520.60	3.85%	封测服务
	合计	10,974.48	55,539.30	84.78%	-

2、前五大应付账款方基本情况

上述供应商的基本情况如下表所示：

序号	供应商名称	成立时间	注册资本	主营业务	股权结构
1	上海华虹宏力半导体制造有限公司	2013年11月	782,857.776万元	主要专注于研发及制造专业应用的200mm晶圆半导体，尤其是嵌入式非易失性存储器及功率器件。	华虹半导体（1347.HK）持股100.00%
2	华虹半导体（无锡）有限公司	2017年10月	180,000.00万美元	300mm集成电路研发和制造	国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股29.00%；上海华虹宏力半导体制造有限公司持股26.78%；华虹半导体有限公司持股22.22%；无锡锡虹凯尧投资有限公司持股20.00%
3	无锡华润上华科技有限公司	2002年7月	66,801.147万美元	为客户提供集成电路制造服务。	华润微电子控股有限公司持股100.00%
4	江苏长电科技股份有限公司	1998年11月	177,955.3万元	半导体封装测试	上市公司（600584.SH）
5	成都集佳科技有限公司	2015年6月	65,000.00万元	致力于专业半导体封装与测试代工的企业	成都士兰半导体制造有限公司持股100.00%
6	扬州国宇电子有限公司	2006年12月	14,848.44万元	主要从事半导体器件芯片的研发生产	中电国基南方集团有限公司持股68.17%；上海凡实投资有限公司持股13.12%；扬杰科技持股3.01%；北京台科源科技有限公司持股8.7%
7	上海芯哲微电子科技股份有限公司	2007年6月	12,478.78万元	主营业务为电源管理领域的集成电路封装测试	上海千亿市政工程有限公司持股27.57%；上海景元投资管理有限公司持股24.15%；上海绿芯电子有限公司持股15.63%；上海芯晨投资管理有限公司持股14.12%；其他股东合计持股18.53%
8	江苏友润微电子有限公司	2011年6月	5,000.00万元	专业从事半导体器件的研究、开发和制造	石华平29%；陈平19%；陈德林10%；李耀宗10%；扬州耐敏德投资管理有限公司10%；刘强9%；王剑平8%；王恩仪5%

根据上表，报告期内，上述前五大应付款方与公司均不存在关联关系。

三、应付票据余额较大的原因及合理性，结合应付票据对手方性质、交易金额等具体情况说明是否存在开具无真实交易背景票据的情形。

1、应付票据余额较大的原因及合理性

报告期内，公司应付票据余额占采购总额比例情况如下：

单位：万元

项目	2021年末/2021年度	2020年末/2020年度	2019年末/2019年度
应付票据余额	8,023.58	7,124.09	8,362.41
采购总额	106,018.96	71,015.89	65,511.31
应付票据占采购总额比例	7.57%	10.03%	12.76%

报告期内，应付票据余额占采购总额比例呈下降趋势，主要原因为：受市场供需关系变化影响，公司第一大供应商上海华虹宏力半导体制造有限公司自2020年开始不接受票据付款所致。

综上，报告期各期末公司应付票据余额与采购规模相关，符合公司业务实际情况，具备合理性。

2、结合应付票据对手方性质、交易金额等具体情况说明是否存在开具无真实交易背景票据的情形

报告期各期，公司开具的应付票据金额分别为13,132.51万元、11,823.20万元、16,346.28万元，其中发生额前五大的对手方占比分别为89.99%、88.78%、82.39%。前述对手方的性质、开具银行承兑汇票金额及当期采购发票入账金额如下：

单位：万元

期间	供应商	性质	开具银行承兑汇票金额	采购发票入账金额
2021年	成都集佳科技有限公司	封测服务商	4,491.24	4,956.51
	江苏长电科技股份有限公司	封测服务商	3,022.25	3,166.89
	江阴苏阳电子股份有限公司	封测服务商	2,516.85	2,521.20
	江苏友润微电子有限公司	封测服务商	2,055.99	2,041.74
	上海芯哲微电子科技股份有限公司	封测服务商	1,381.33	3,275.77
	合计		13,467.66	15,962.11
2020年	江苏长电科技股份有限公司	封测服务商	3,601.79	3,839.57
	成都集佳科技有限公司	封测服务商	2,777.71	3,076.32
	江阴苏阳电子股份有限公司	封测服务商	2,091.48	2,403.31
	上海芯哲微电子科技股份有限公司	封测服务商	1,026.18	2,297.28
	无锡华润上华科技有限公司	芯片代工商	1,000.00	8,550.93
	合计		10,497.16	20,167.41
2019年	上海华虹宏力半导体制造有限公司	芯片代工商	4,556.75	46,733.43
	江苏长电科技股份有限公司	封测服务商	2,442.80	4,304.81
	成都集佳科技有限公司	封测服务商	1,996.30	2,716.34
	无锡华润上华科技有限公司	芯片代工商	1,413.59	10,279.43
	江阴苏阳电子股份有限公司	封测服务商	1,409.12	2,304.56
	合计		11,818.56	66,338.57

注：

1、公司通常在取得发票后，根据款期支付货款，因此对比供应商发票入账金额与应付票据开具金额匹配性更高。发票入账金额与采购额的差异主要系期初、期末采购暂估所致。

2、2021年，开具给江苏友润微电子有限公司银行承兑金额略大于采购发票入账金额，原因系部分支付2020年的采购货款所致。

根据上表，公司的票据开具对手方主要为封测服务商、芯片代工商，票据开具金额整体小于交易发生额，公司开具的应付票据与对手方、交易规模整体匹配，不存在开具无真实交易背景票据的情形。

【中介机构核查意见】

（一）核查程序

1、对发行人高管进行访谈，查阅了公司的内部控制文件，了解公司的采购政策；

2、获取了公司报告期各期末应付账款和应付票据明细情况，与公司高管沟通了解应付账款和应付票据的合理性；

3、查阅了公司报告期内主要供应商的采购合同及订单，了解公司的采购内容及采购规模等，并与应付账款及应付票据明细进行比对分析，了解应付账款和应付票据较高是否具有合理性，是否存在开具无真实交易背景票据的情形；

4、通过公开渠道查询报告期内前五大应付款方基本情况，了解其与公司是否存在关联关系。

（二）核查意见

经核查，保荐机构和申请人会计师认为：

1、报告期内，公司应付账款余额随自身业务发展和生产经营的实际情况而波动，应付账款规模与公司采购政策和业务规模相匹配，具有合理性。

2、报告期内前五大应付款方与公司不存在关联关系。

3、报告期各期末公司应付票据余额随自身业务发展和生产经营的实际情况而波动，应付票据规模与公司采购政策和业务规模相匹配，具有合理性。

4、公司存货金额较高符合公司业务发展实际和行业特点，且存货占流动资产比例低于同行业可比上市公司平均值，存货规模具备合理性。

5、公司应付款余额较大，期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形，公司可能与财务性投资核算相关的报表